

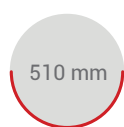
# GAP-351R - Serie G6 SERVER RUGGED 3U

Intel® Xeon® Scalable

I/O Motherboard e Alimentatore Posteriori



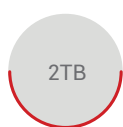
Piattaforma



Profondità



CPU



RAM



SSD



Schede I/O

**GAP** è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

I server rugged GAP-351R Serie G6 integrano singolo o doppio processore della serie Intel® Xeon® Scalable Processors (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) che offre fino a 28 core e 56 thread, fino a 38.5 MB di cache L2, la nuova UPI (Ultra Path Interface), fino a sei canali di memoria, supporto AVX-512 e fino a 48 linee PCIe 3.0. I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità.

GAP-351R è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 3U di altezza e 510mm di profondità.

La configurazione con I/O motherboard e alimentatore posteriori può ospitare quindici SSD estraibili, tre SSD interni e un DVD slim. I server rugged serie GAP-351R possono integrare fino a sei schede PCIe. Le schede aggiuntive possono essere provviste di sistemi di fissaggio dedicati per garantire il funzionamento ottimale anche in presenza di shock e vibrazioni o durante il trasporto.

I server rugged GAP sono conformi alle MIL-STD-810F per temperatura e shock, alle MIL-STD-167-1A per vibrazioni e opzionalmente alle normative MIL-STD-461. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

## CARATTERISTICHE

- Server Rugged 3U - 510mm profondità
- Singolo o doppio processore
- Intel Xeon® Scalable (I e II Gen)
- I/O motherboard posteriori
- Ingresso di alimentazione posteriore
- Alimentatore Ridondato AC o DC
- Fino a 15 SSD Hot Swap + 3 SSD interni
- DVD opzionale
- Fino a 6 schede PCIe
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

## Specifiche Tecniche

### Sistema

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Processore</b>          | Famiglia Intel® Xeon® Scalable (fino a 140W TDP) - Doppio Socket P (LGA 3647) - Fino a 28 core<br>Famiglia Intel® Xeon® Scalable (fino a 165W TDP) - Singolo Socket P (LGA 3647) - Fino a 28 core |
| <b>Memoria</b>             | Fino a 2TB ECC RDIMM, DDR4-2933MHz  |
| <b>Chipset</b>             | Intel® C621   |
| <b>Porte rete</b>          | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet<br>1 x RJ45 dedicata IPMI   |
| <b>Storage</b>             | 2.5" SATA Disk - RAID 0, 1, 5, 10   |
| <b>TPM</b>                 | 1 TPM Header  |
| <b>I/O motherboard</b>     | Disponibili sul retro: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN (Motherboard Doppio Socket)<br>1 x VGA; 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN, 1 x COM (Motherboard Singolo Socket)  |
| <b>Schede aggiuntive</b>   | Fino a 6 Schede PCIe Low profile  |
| <b>Sistemi operativi</b>   | Windows® 8.1, Windows® 10 IoT Enterprise 2016, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016, Linux, Vmware   |
| <b>IPMI</b>                | IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail   |
| <b>Monitoraggio remoto</b> | Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID)                      |

### Alimentazione

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Alimentatore</b> | 100/240 VAC Ridonato<br>18-36 VDC Singolo o Ridonato<br>36-72 VDC Singolo o Ridonato |
|---------------------|--|

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Dimensioni</b>        | 483 x 133 x 510 mm   |
| <b>Materiale</b>         | Alluminio con trattamento di passivazione superficiale   |
| <b>Colore</b>            | Silver   |
| <b>Alloggiamento</b>     | Chassis 3U per montaggio a rack 19"<br>Guide telescopiche opzionali  |
| <b>Configurazione</b>    | I/O motherboard e alimentatore posteriori  |
| <b>Pannello frontale</b> | Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset; Connettori: 2 x USB 2.0 |
| <b>Baie Drive</b>        | 1 x 5.25" slim; 5 x baia 3.5" + 1 x baia interna x 3 ODD 2.5"  |

### Parametri Ambientali - (Design to meet)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Temperatura operativa</b> | Standard: 0°C / +50°C<br>Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)  |
| <b>Umidità operativa</b>     | Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)  |
| <b>Temperatura storage</b>   | -40°C / +70°C  |
| <b>Vibrazioni</b>            | MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes                                   |
| <b>Shock operativo</b>       | MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms - half sine   |
| <b>Shock trasporto</b>       | MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth  |
| <b>Certificazioni</b>        | Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC<br>Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH |

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.